



大联大控股  
A Member of WPG Holdings

世平集团

World Peace Industrial Group



# 化身聚合商角色 世平协助客户找到AI新商机





近一两年，AI (Artificial Intelligence, 人工智能) 再次成为全球焦点，不同于过去两次热潮都仅局限在科技领域，这次的 AI 因挟着高速运算技术与大数据而来，可应用于现在绝大多数领域，因此受到各大产业瞩目，并被视为引领全球产业转型智慧化的关键。

不过也由于应用范围过广，不仅 AI 运算平台业者无法具备各垂直应用产业的专业知识，加上 AI 本身的专业技术需求，也对各行业形成导入门坎，在技术面的落差下，供需双方难以对接。近年来 Intel® 推动的聚合商机制 (Intel® IoT Solution Aggregator)，则解决了此一困境，作为 Intel® 全球仅有 4 家聚合商之一的世平集团，虽为全球芯片第一大通路商，除原有的硬件能力外，特别成立具有 AI 技术的软件部门，结合各产业的专业知识，可为协助客户快速打造实时可用的特定领域垂直解决方案，掌握市场先机。

AI 已成全球产业的既定趋势，只要快同业半步，就能站稳未来市场的脚步，不过就如前文提到，AI 系统的导入需要一定技术门坎，此一门坎包括 IT 与特定领域两大专业知识，才能设计出最优化系统。

## AI 趋势启动 应用渐趋多元



AI 所需要的技术包括无非软硬件两大部分，而这两大部分的架构选择，都需要视企业架构系统

的目的而定。企业导入 AI 无非是透过其运算能力，协助营运系统的运作，因此必须先了解系统的应用方向，才能选择适合的硬件平台与软件架构。

观察目前市场状况，影像识别是 AI 目前最广泛的应用，主要原因在于影像设备普及，且应用目标明确，例如在门禁、海关，甚至是警政单位监控画面中的脸孔识别，AI 都扮演了重要角色，因此影像辨别成为 AI 普及的第一步。

例如：近年来在智慧手机与家用市场掀起热潮的语音助理，现在仅止于语意识别，仍未能从与声音辨别出个人身分，这方面的技术若能加强，再加上对自然语意的辨识能力，未来的应用将会更宽广，事实上现在已有系统业者，利用 AI 的深度学习算法设计出聊天机器人 (Chatbot)，使其可辨识文字的自然语意，并将其应用于金融、零售等产业的客服系统。

由市场现况可以看出，AI 的应用面向十分宽广，尤其是与物联网 (IoT, Internet of Things) 所整合而成的 AIoT，更将成为各产业未来的骨干架构。

不过，要将 AI 置入企业现有系统，使其具有智能元素，并让系统可以落地应用，系统功能能否贴合用户需求将是关键，这也考验了系统业者的设计能力；而为了强化业者能力，多数厂商都推出了开发工具包。作为全球处理器第一品牌，Intel® 近年来也积极强化 AI 的部署，除了提供对应的芯片组外，2018 年也推出开放资源 (Open source) OpenVINO™ 开发平台，让系统厂商可以此开发相关应用。



## Intel® 产品布局 满足市场 4 大需求

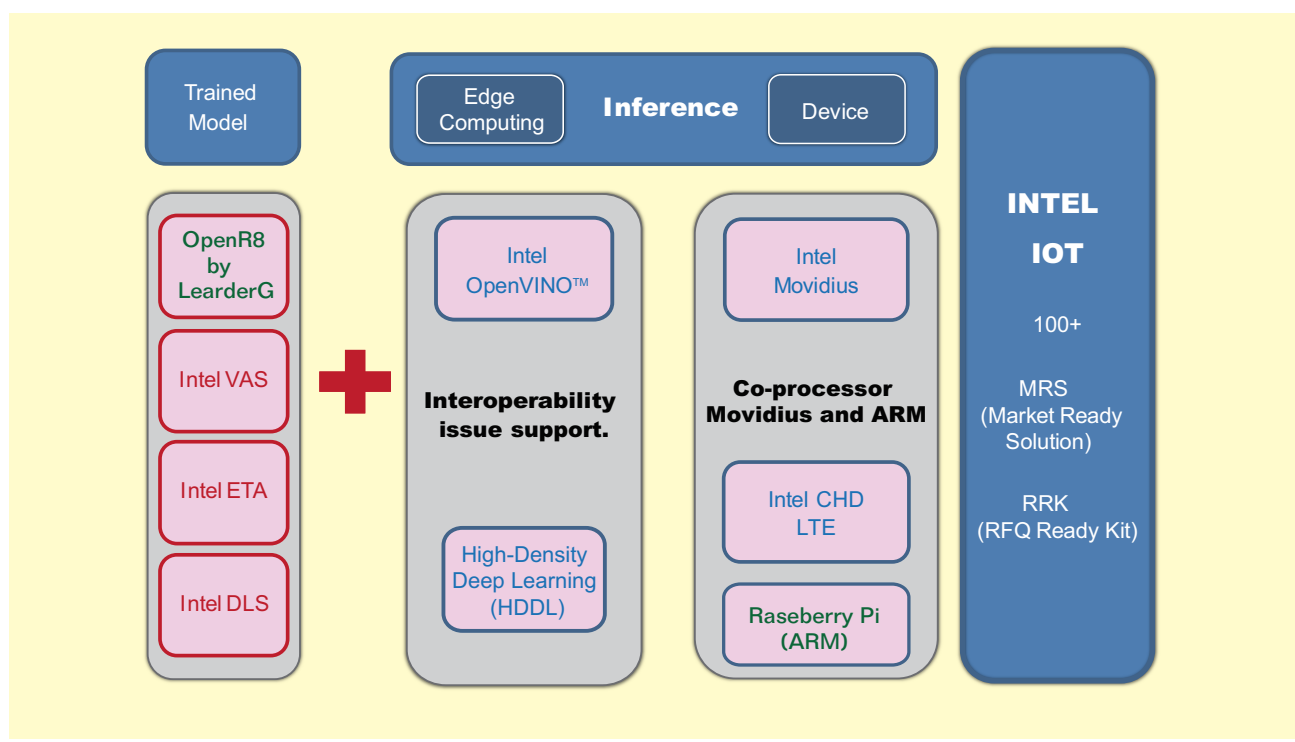
不过 AI 的应用广泛，单一芯片组与开发工具包难以全部涵盖，因此还需要链结不同产业的资源，组成生态系统，才能因应市场需求。就世平集团的观察，目前市场上对 AI 有需求的厂商可分为 4 类，这 4 类厂商都可透过 Intel® 解决方案与身为聚合商的世平集团满足。

首先特定领域的系统整合商，这类型厂商具有特定领域专业知识，但资源有限无法建构 AI 系统，这种厂商需要已针对该领域设计好的 AI 解决方案，再结合本身的专业知识，即可让系统上市使用，对此现在市场上会已有开发商使用 Intel® 的 MRS\* (Market Ready Solution；市场就绪解决方案) 或 RRK\* (RFP Ready Kit；物联网开发工具包)，设计出为特定领域所需的模块化产品，世

平集团则扮演产业生态系统的聚合角色，让双方业者结合供需。

第二类厂商则是希望让已然设计完成的终端产品再一次升级，这类型产品的架构都已设计完成，但希望在不影响原有架构下，用最小的研发资源，使产品具有特定的 AI 功能，这时就可加入已具有 AI 功能的 Intel® 芯片 Movidius，在有限的资源投入与架构变动下，完成产品升级。

第 3 类厂商则是要让现有的 x86 架构可弹性扩充运算能力，这类型厂商主要产品多为工控系统，其系统的应用情景多元，单一系统难以满足所有客户所需，然而如果针对每一客户提供客制化设计，成本会过高，因此大多会先设计出市场最高公约数需求的架构，并留下弹性调整空间，当客户提出需求，再视状况变动，而 Intel® 的加速卡



图示：世平兴业为客户提供针对 Intel® AI Vision 及 Intel® OpenVINO™ 解决方案的增值服务



HDDL 与 OpenVINO™\* 开发平台，就可在不更动原有架构下，以版卡扩充方式增加系统算力，省下系统重新开发所需的成本。最后一种则是希望在既有系统中快速导入 AI 功能，由于 AI 的运作分为训练 (Training) 与推论 (Inference)，AI 模块必须先在前端训练过，使之具备特定运作模式，再将训练过的模块与既有系统整合，加上原来设定的应用，即可成为具智能化的系统。以工厂制程检测为例，前端训练模式可让 AI 模块具备判断产品好坏能力，训练完的模块再与原有的制程设备整合应用于产线，产线即有智能检测的判断功能。

不过前端的训练需要有高度算法能力，并熟知各特定功能的专业知识，才能设计出正确的训练模型，目前世平集团已有 AI 训练平台，此平台内含 Intel® 的 CPU 与加速卡 HDDL，而为因应不同的应用领域与场景，此平台也采用了 OpenVINO™ 开发工具包，藉此设计出符合特定场域的训练模式，除了采用 Intel® 产品所建置的训练平台外，世平集团也与各领域的特定厂商配合，例如制造业就与自动光学检测厂商立达软件科技合作，透过其 OPENR8，训练生产设备的影像辨识能力，让制程的检测环节具备 AI 功能，提升生产效率。

## 世平集团角色重新定位 聚合供需两端信息

包括产业与一般使用者在内，过去多认为 AI 的效能必然强大，所需要的算力也非常高，不过从上述 4 种厂商需求，就可看出，AI 的应用多元，所需要的架构与算力也不尽相同，例如在自驾车系统中，AI 必须具备与云端平台链接的功能，链接路上所有信息，至于工厂检测或家用人脸辨识

系统，就只要让设备在前端具备简单判断影像的能力，并不需要与后端平台介接，所需算力也不须太高，而世平集团会协助不同类型的应用，协助客户发展自有系统。

由布局与服务提供可以看出，在 AI 趋势下，世平集团在市场的角色已开始转变，不过这并非第一次转变，因应市场的变动，世平集团一直不断调整本身的市场地位。最早期的 IC 代理商，主要是销售各厂牌的电子组件，之后市场应用渐多，FAE 需求浮现，世平集团开始协助客户强化 IC 组件的应用能力，近年来整体解决方案成为重点，世平集团进一步整合旗下代理的产品，提供一站式解决方案 (Turnkey solution)，而在 AI 时代，世平集团则化身为聚合平台。

过去 IC 应用主要是笔记本电脑、手机等消费性电子产品大厂，客户和应用相对单纯，但在 AI 时代，应用太过广泛，制造、医疗、交通、零售... 几乎想得出来的各类型产业都有可能导入 AI，这些产业不但种类多，而且单一产业的数量需求并不大，Intel® 之类的大厂无法针对单一应用推出专属产品，也因此 Intel® 以 MRS、RRK 这类型方案，提供建置到一定程度的架构平台，让系统业者加上专属设计，即可打造出贴身产品，并将产品放上 Intel® 的媒合平台上，让有需求的业者可以上平台找到合适产品，加速系统上线时间。

而世平集团的聚合商角色，就是将 Intel® 的产品整合为各领域的解决方案，并透过其长年在各地区、各领域所建立的管道通路，找到合适的系统整合商或终端用户，将合适的方案提供给有需求的业者。

现在投入 IIoT、AIoT 等架构开发的新创厂商非



常多，有些或许知名度不高、规模不大，不过产品具有应用潜力，这些厂商由于资源有限，难以将产品营销到各地，透过世平集团的力量，就可以让产品做最大化曝光，目前世平集团在 Intel® 的聚合平台中，主要负责亚洲市场，从 2018 年开始，就已在马来西亚、泰国等国举办媒合活动，2019 年更将触角拉入软件力极大的印度市场，寻找当地产业的 AI 商机，并将产品介绍出去，这对缺乏人力、资源、经验的新创业者来说，是最有效益的产品营销机会，这也是世平集团长年耕耘各领域市场所建立的优势。

## 产品优势十足 协助厂商抢占先机

世平集团的产业经验结合 Intel® 平台，让 AI 的供需双方有了最佳媒合机会。就目前 AI 与物联网的蓬勃下，除了 Intel® 外，目前市场上也有类似的媒合平台，不过，Intel® 的优势是其他平台难以企及。

首先是 Intel® 已设计出 MRS、RRK 等众多销售管道，这些管道扩张了产品的接触面，大幅提升曝光度，在云端平台方面，Intel® 也已宣示将在 2019 年启动相关服务，最后则是普及度，Intel® 的 CPU 已经是全球最普及的 x86 处理器架构，而由于 Intel® 从第 6 代 CPU 开始，就在内部建有 GPU 芯片组，而且之后一路扩张，到第



图示：Intel® Movidius Myriad X 芯片

9 代 CPU，其 GPU 比例已占一半，在架构中，CPU 与 GPU 可以同步运算，并在 OpenVINO 平台升级，使之具有 AI 功能，而若有更大的算力需求，也可加入 Intel® 加速卡，扩充演算能力。

随着应用的逐渐落地，AI 在产业的普及速度已然加快，企业要强化竞争力，AI 已经是必然选择，而无论是系统设计者或用户，都必须找到自己的切入点，而就技术面来看，现在各产业应用所需的 AI 技术都已就绪，只要加上自己的想法与创意，就可让应用成真，而透过 Intel® 体系中世平集团的聚合商角色，过去因信息与资源有限，导致供需两端难以对接的问题，将会迎刃而解，未来世集团将会持续扩大生态圈，结合 Intel® 与世平集团本身在各领域的专业能力，协助业者将产品找到合适的需求者，在 AI 趋势中站稳脚步。

---

### 想了解更多关于 Intel® 聚合商、Intel® MRS、Intel® RRK 与 Intel® OpenVINO™

- 英特尔物联网解决方案聚合商 (Intel IoT Solution aggregator)
- 英特尔是场就绪解决方案 (Intel MRS (Market-ready-solutions))
- 英特尔物联网开发工具包 (Intel RRK (RFP Ready Kit))
- 英特尔 OpenVINO™ 开发工具包  
(Intel OpenVINO (Open Visual Inferencing and Neural Network Optimization))



大联大控股  
A Member of WPG Holdings



**世平集团**  
World Peace Industrial Group

大联大商贸 – 世平集团  
WPG China Inc. – WPI Group  
中国上海市嘉定区金沙江西路1555弄37号 (邮编201803)  
Tel: 86-21-2309 9388  
Fax: 86-21-69513976



世平物联网聚合商



世平集团官网

© World Peace Industrial Co., Ltd.